

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年10月29日(29.10.2020)



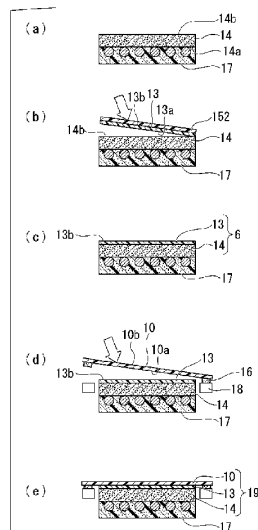
(10) 国際公開番号

WO 2020/218519 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 27/16 (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01) *B32B 7/025* (2019.01)
B23K 26/00 (2014.01) *B32B 7/04* (2019.01)
B32B 15/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/017717
- (22) 国際出願日: 2020年4月24日(24.04.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-086298 2019年4月26日(26.04.2019) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町23番23号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 上道 厚史 (UEMICHI Atsushi); 〒1730001 東京都板橋区本町23番23号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 根本 拓 (NEMOTO Taku); 〒1730001 東京都板橋区本町23番23号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 中石 康喜 (NAKAISHI Yasunobu); 〒1730001 東京都板橋区本町23番23号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 古野 健太 (FURUNO Kenta); 〒1730001 東京都板橋区本町23番23号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING THREE-LAYER BODY, METHOD FOR PRODUCING FOUR-LAYER BODY, METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH REAR SURFACE PROTECTIVE FILM, AND THREE-LAYER BODY

(54) 発明の名称: 第三積層体の製造方法、第四積層体の製造方法及び裏面保護膜付き半導体装置の製造方法、並びに、第三積層体



(57) Abstract: The present invention relates to a method for producing a three-layer body (19) including the following steps in this order: a first layering step in which one surface of a workpiece (14) is a circuit surface (14a) and the other surface is a rear surface (14b), one surface of a film (13) for forming a rear surface protective film is a smooth surface (13b) and the other surface is a rough surface (13a) rougher than the smooth surface (13b), and the rough surface (13a) of the film (13) for forming a rear surface protective film is made to face the rear surface (14b) of the workpiece (14) and affixed thereto; and a second layering step in which a support sheet (10) is affixed to the smooth surface (13b) of the film (13) for forming a rear surface protective film.

(57) 要約: 本発明は、ワーク(14)の、一方の面が回路面(14a)であり、他方の面が裏面(14b)であり、裏面保護膜形成用フィルム(13)の、一方の面が平滑面(13b)であり、他方の面が平滑面(13b)よりも粗い粗面(13a)であり、ワーク(14)の裏面(14b)に、裏面保護膜形成用フィルム(13)の粗面(13a)を向い合せて貼付する第一の積層工程と、裏面保護膜形成用フィルム(13)の平滑面(13b)に、支持シート(10)を貼付する第二の積層工程とを、この順に含む、第三積層体(19)の製造方法に関する。

[続葉有]

WO 2020/218519 A1

(74) 代理人: 西澤 和純, 外(NISHIZAWA Kazuyoshi et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))